

ANMELDUNG

„Elektronik am Limit II“ 2013 Symposium zum Thema „Automotive, Aerospace, Medizintechnik“

Faxantwort bitte an Frau Orkide Karasu, +49 (0) 231 / 97 42 - 150

- Ich melde mich für die Elektronik am Limit II als Teilnehmer an.**
Die Tagungsgebühr beträgt 498,00 € bei Anmeldung bis zum 18.02.2013. Danach beträgt die Tagungsgebühr 528,00 €. Im Preis enthalten sind Getränke, Snacks und die Abendveranstaltung. Die Tagungsunterlagen werden den Teilnehmern in einem geschlossenen Downloadbereich bereit gestellt.
- Ich bin IVAM-Mitglied und möchte an der Elektronik am Limit II teilnehmen.**
Die Tagungsgebühr beträgt 468,00 € bei Anmeldung bis zum 18.02.2013. Danach beträgt die Tagungsgebühr 498,00 €. Im Preis enthalten sind Getränke, Snacks und die Abendveranstaltung. Die Tagungsunterlagen werden den Teilnehmern in einem geschlossenen Downloadbereich bereit gestellt.

Jedem weiteren Teilnehmer aus demselben Unternehmen gewähren wir eine Vergünstigung von 50 €.

- Ich nehme an der Abendveranstaltung am 06.03.2013 teil.**
Details zur Lokalität werden Ihnen nach der Anmeldung mitgeteilt.
- Ich buche einen Platz in der begleitenden Table-Top-Ausstellung.**
Die Gebühr beträgt 198,00 €. Im Preis enthalten ist 1 Sitztisch. Die Ausstellung ist auf 15 Teilnehmer begrenzt.

Titel, Vorname, Nachname

Firmenname für die Rechnungsstellung

Rechnungsanschrift

Telefon

Fax

E-Mail

Datum / Unterschrift

Alle Preise zzgl. 19 % MwSt. Bei Anmeldung erhalten Sie eine Rechnung. Bei Absage bis zum 20.02.2013 trotz verbindlicher Anmeldung wird eine Stornogebühr in Höhe von 50,00 € berechnet, danach wird die volle Gebühr erhoben. Selbstverständlich ist die Nennung eines Ersatzteilnehmers jederzeit und ohne zusätzliche Kosten möglich.

ANFAHRT

TechnologieZentrumDortmund
Emil-Figge-Str. 76 – 80
D-44227 Dortmund

Parkplätze:
Tiefgarage
TechnologieZentrumDortmund
Martin-Schmeißer-Weg

Anreise per PKW

Aus Richtung Norden

A1 bis AK Kamen (Kamener Kreuz), A2 Richtung Oberhausen bis Dortmund-Nordwest. Dann A 45 Richtung Frankfurt bis Dortmund-West. Weiter auf der A40/B1 (weiter siehe aus Richtung Westen und Osten).

Aus Richtung Westen und Osten:

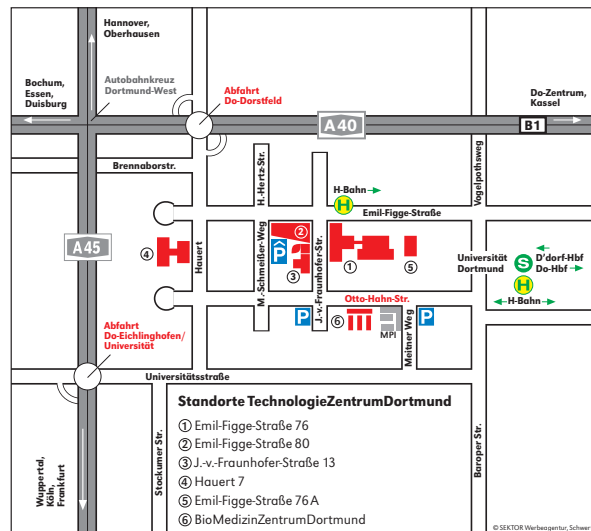
A44/A40/B1 bis zur Abfahrt Dortmund-Dorstfeld/Universität. Rechts in die Wittener Straße und über die nächste Ampelkreuzung geradeaus in den Hauert. Links einordnen und an der nächsten Kreuzung links in die Emil-Figge-Straße. 150 m weiter rechts in den Martin-Schmeißer-Weg und sofort links in die Tiefgarage.

Aus Richtung Süden:

A45 bis Abfahrt Dortmund-Eichlinghofen/Universität. Rechts in die Universitätsstraße, über die nächste Ampelkreuzung geradeaus. Links einordnen und in den Hauert einbiegen. Geradeaus bis zur zweiten Ampelkreuzung, dann rechts in die Emil-Figge-Straße. 150 m weiter rechts in den Martin-Schmeißer-Weg und links in die Tiefgarage.

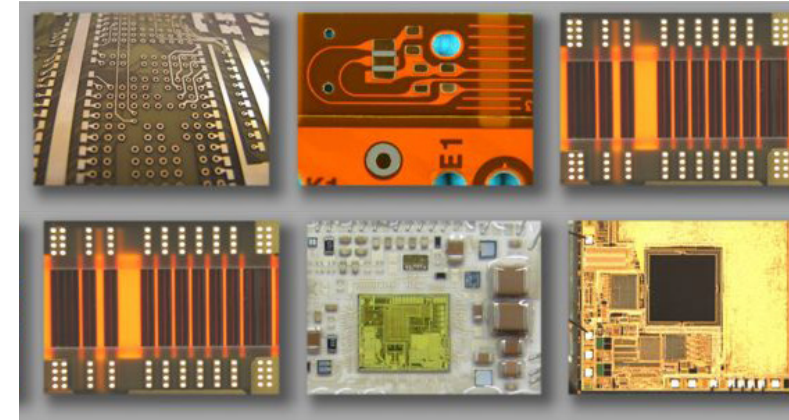
Anreise per Bahn

Vom Dortmunder Hauptbahnhof mit der S-Bahn Linie S1 Richtung Solingen, Ausstieg Universität, anschließend mit der H-Bahn zum TechnologieZentrumDortmund.



SGS

IVAM



Quelle: SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

6./7. MÄRZ 2013,
DORTMUND

„ELEKTRONIK AM LIMIT II“
AUTOMOTIVE
AEROSPACE
MEDIZINTECHNIK

go-cluster
EXZELLENT VERNETZT!

ELEKTRONIK AM LIMIT II Symposium für Automotive, Aerospace und Medizintechnik

Sehr geehrte Damen und Herren,

Automotive, Aerospace und Medizintechnik - dies sind die Branchen, in denen Hightech und Innovationen scheinbar keine Grenzen gesetzt sind. Stimmt das? Die Elektronik wird immer weiter entwickelt, schafft neue Möglichkeiten, revolutioniert die Produkte. Ohne Ende?

Der IVAM Fachverband für Mikrotechnik und die SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH möchten Sie herzlich einladen, diese und weitergehende Fragen am 6. und 7. März 2013 in Dortmund im Rahmen der Veranstaltung „Elektronik am Limit II“ zu diskutieren. Das branchenübergreifende Fachforum bietet Vorträge zu vielfältigen Themen der Elektronik, wie beispielsweise innovative Sensor-Konzepte, Anforderungen an Elektronik für sicherheitskritische Anwendungen, neuartige Methoden in der Aufbau- und Verbindungstechnologie sowie Fragen zur Robustheit von Halbleiter-Komponenten.

Freuen Sie sich auf spannende Gastbeiträge von führenden Experten aus den Bereichen Automotive, Aerospace und Medizintechnik. Die Vortragsreihe richtet sich an Mitarbeiter von OEMs oder Zulieferern in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Qualitätssicherung sowie strategisches Produktmanagement und an Angehörige von Universitäten bzw. öffentlichen Instituten, die sich mit der Entwicklung innovativer Technologien beschäftigen.

Am Abend des 1. Veranstaltungstags bieten wir Ihnen zudem die Möglichkeit, im Rahmen einer festlichen Abendveranstaltung bei Buffet und Getränken effiziente Netzwerkpflge zu betreiben und den Tag gemeinsam ausklingen zu lassen.

Wir freuen uns sehr über Ihre Teilnahme am 6. und 7. März in Dortmund!



Dr. Olaf Günnewig
SGS INSTITUT FRESENIUS



Dr. Frank Bartels
IVAM Fachverband für Mikrotechnik

Mittwoch, 06. März 2013

10.20 Uhr	Begrüßung	Dr. Olaf Günnewig , SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH
Session 1: Aufbau- und Verbindungstechnologie		
10.30 Uhr	Funktionsintegration in Leiterplatten	Hans-Jörg Etter OPTIPRINT AG, Berneck, CH
11.00 Uhr	Konforme Parylene-Beschichtung: Größere Zuverlässigkeit für elektronische Schaltungen	Guido Wolf Speciality Coating Systems, Sheerwater, Woking Surrey, UK
11.30 Uhr	Limits überwinden mit 3D-MID Technologie	Albert Birkicht HARTING AG Mitronics, Biel, CH
12.00 Uhr	MID - miniaturisierte AVT im 3D-Format	Uwe Remer 2E mechatronic GmbH & Co. KG, Kirchheim/Teck, DE
12.30 Uhr	Effizientes Wärmemanagement von Leiterplatten bei Leistungselektronik- und LED-Anwendungen	Norbert Krütt FELA GmbH, Villingen-Schwenningen, DE
13.00 Uhr	Mittagspause	
Session 2: Komponenten, MEMS & Sensorik		
14.00 Uhr	Digital Photon Counting Technology - Hochintegrierte skalierbare Lichtsensoren für unterschiedliche Anwendungen	Dr. York Hämisch Philips Digital Photon Counting, Aachen, DE
14.30 Uhr	LTCC-/Keramik-Boards für Hochtemperatur-Anwendungen	Frank Kranhold Micro-Hybrid Electronic GmbH, Hermsdorf, DE
15.00 Uhr	Herausforderungen bei der Qualitätssicherung von High-End-Elektronik im Automobilbereich	Sabine Knopke Robert Bosch GmbH, Reutlingen, DE
15.30 Uhr	Kaffeepause	
16:00 Uhr	Systemintegration - Schlüssel zum Erfolg im Sensorik-Massenmarkt	Dirk Enderlein MEAS Deutschland GmbH, Dortmund, DE
16.30 Uhr	Hochtemperaturschaltungen auf Dünnschicht-SOI	Alexander Stanitzki Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische Schaltungen und Systeme IMS, Duisburg, DE
ab 17.00 Uhr	Netzwerkveranstaltung mit Getränken und Buffet	

Donnerstag, 07. März 2013

Session 3: Qualitätssicherung und Funktionale Sicherheit		
10.00 Uhr	Funktionale Sicherheit in Automotive, Aerospace und Medizintechnik	Jan Edel SGS TÜV Saar GmbH, Dortmund, DE
10.30 Uhr	Sichere Authentifizierung in einer M2M Kommunikation im MedTec Bereich	Matthias Lorenz AEMTec GmbH, Berlin, DE
11.00 Uhr	Grenzen der Power-MOS-Technologie im modernen Automobil	Prof. Dr. Felix Hüning FH Aachen, Aachen, DE
11.30 Uhr	Murphy must be an optimist: COTS-Komponenten in der Luftfahrt – Eine Herausforderung !?	Bernhard Köbel Diehl Aerospace GmbH, Frankfurt, DE
12.00 Uhr	Update: Qualitätssicherung für Halbleiter in der Automobil-elektronik	Jörg Putz ELMOS Semiconductor AG, Dortmund, DE
12.30 Uhr	Mittagssnack und Abschluss der Veranstaltung	